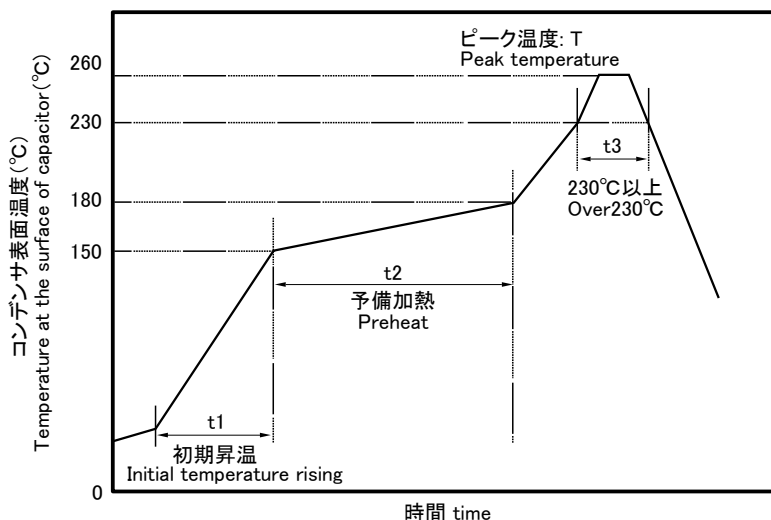


●基板実装条件/SOLDERING CONDITIONS

◆リフロー条件/REFLOW SOLDERING CONDITION



初期昇温区間 : t1 Period of initial temperature rising	予備加熱区間 : t2 Period of preheat	230°C以上区間 : t3 Period over 230°C	ピーク温度 : T Peak temperature
常温 (room temperature) ~150°C 3°C/ sec MAX	150~180°C 60~120 sec	30~60 sec	260°C MAX

※温度測定位置は、コンデンサ積層体表面とする。Temperature is measured at the surface of capacitor.

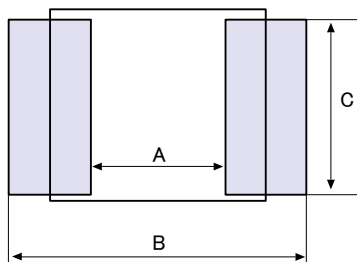
- 1) ピーク温度での滞留は極力短くしてください。
Holding time at the peak temperature should be as short as possible.
- 2) リフローの繰り返し回数は2回までとし、2回目のリフローはコンデンサ温度が常温に戻ってから行ってください。
Reflow soldering cycle is limited to two (2). The second soldering should be done after the capacitor itself has returned to room temperature.
- 3) 推奨温度プロファイルとは異なる条件でリフロー実装を行う場合には、事前にお問い合わせください。
Please consult us in advance if your reflow soldering condition is different from recommended condition.

◆フロー条件/FLOW SOLDERING CONDITION

フロー条件についてはお問い合わせください。
Please consult us about flow soldering condition.

◆推奨ランドパターン/RECOMENDED LAND PATTERN

コンデンサ実装用のランド寸法は、極力下表の設計値をご使用ください。
但し、フロー実装の場合にはB寸法を下表よりも0.4~0.6mm程度大きくしてください。
ランド設計値が推奨値と大幅に異なる場合は、事前にお問い合わせください。
For designing land size, refer to the following recommended land size.
However, in flow soldering, please enlarge B dimension about 0.4 to 0.6 mm.
Please consult us in advance if your land design is vastly different from recommended land size.



チップサイズ Chip Size	ランド寸法記号(mm) Dimensions		
	A	B	C
1608	0.5	2.0	0.7
2012	0.8	2.4	1.1
3216	1.8	3.6	1.4
3225	1.8	3.6	2.3
4532	2.7	5.7	3.0
5750	3.5	7.8	4.5
3245	1.8	3.6	4.1